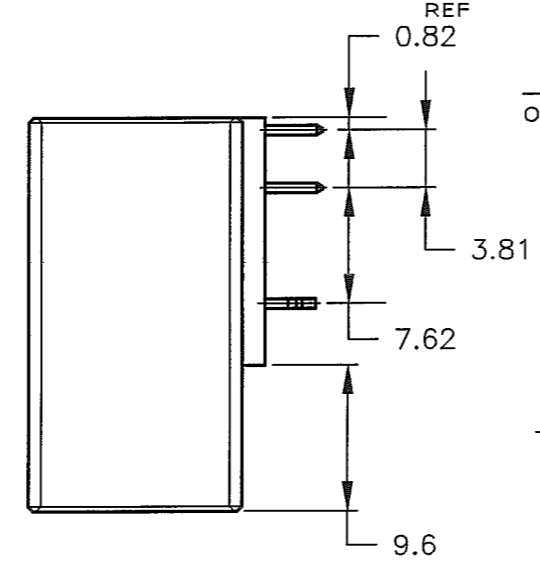
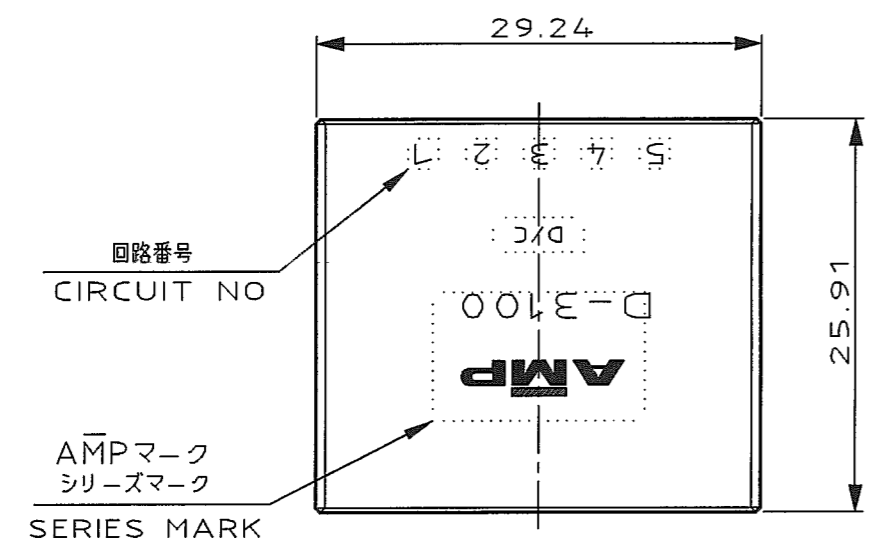


NUMBER 179613

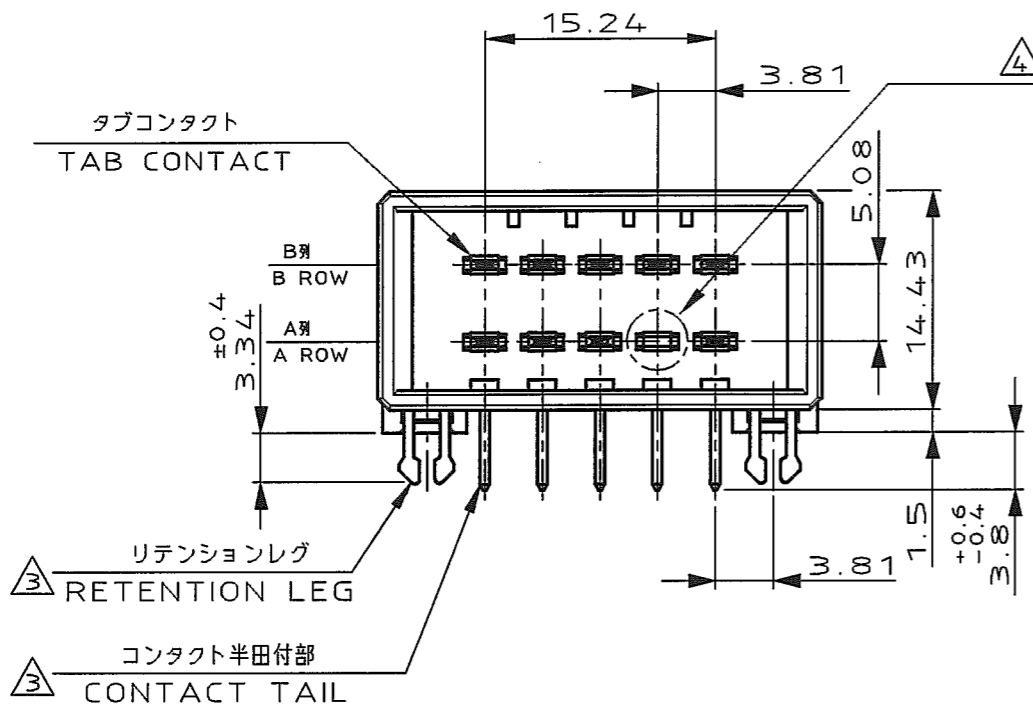
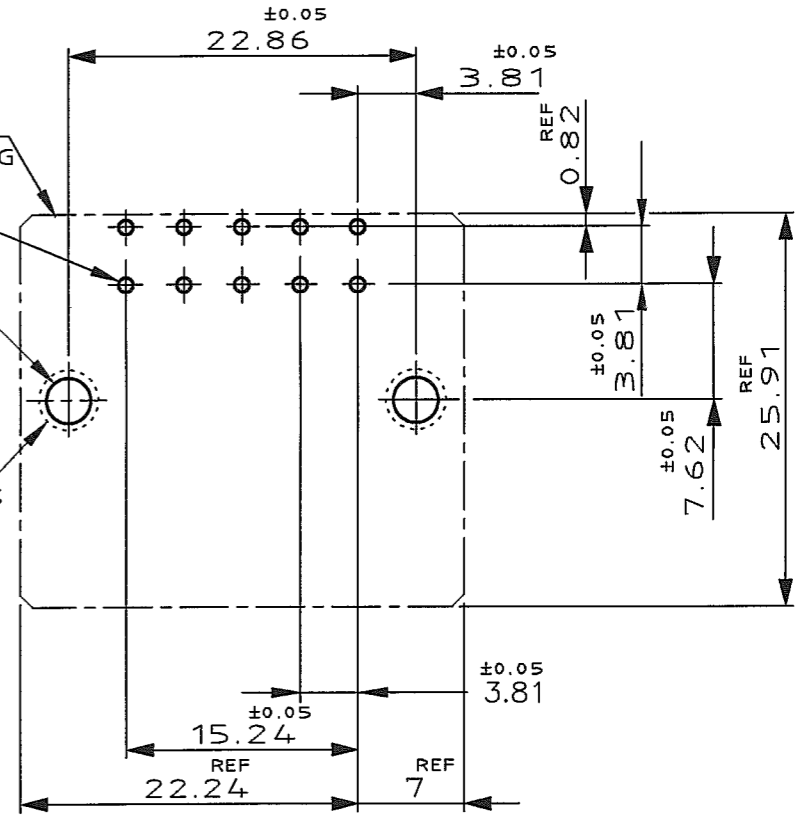


METRIC

PRINT DIST 真価: 寸法 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT



- コネクタ外形
OUTLINE OF HEADER HOUSING
- 10-φ1.1 ±0.1
DIA 1.1±0.1 10PLACES
- スルーホール 2-φ3 ±0.1
DIA 3±0.1 2PLACES
- ラウンド 2-φ4MIN
ROUND DIA 4MIN 2PLACES



推奨基板取付け穴寸法
PC 基板厚: 1.6±0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILED THERMO PLASTIC, POLYESTER
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG) (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- CIRCUIT NO. 4 OF A ROW: EMPTY

注記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性
ポリエステル樹脂
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MIN スズめっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
: ニッケル下地のの上にスズめっき
- A 列の4番は空にする。

△3 △2	179613-5
(FINISH)	製品番号 (PART NO.)

A	REVISED (FJD0-0114-03)	T.S.S.M	4/25/94
O	RELEASED (FJ00-0084-94)	K.S.M	2/FEB/94
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK DATE

Copyright ©1994年 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		Copyright ©1994 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.	
結合線径 (WIRE RANGE)	絶縁外径 (INSULATION DIA.)	材料 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)
mm ² (AWG -)	mm ²	注記参照 SEE NOTE	注記参照 SEE NOTE
DR. K.IKEDA	DE. K.IKEDA	CHK. S.MANABE	APP. S.MANABE

Copyright ©1994 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		Copyright ©1994 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.	
10 POS DOUBLE ROW WITHOUT 1 POS HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100		Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		名称 (NAME)	
10mm ² : ±0.35	10mm ² 以下 : ±0.4	10 POS DOUBLE ROW WITHOUT 1 POS HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100	
30mm ² 以下 : ±0.45	角 : ±3'	10 POS DOUBLE ROW WITHOUT 1 POS HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100	
尺度 (SCALE)		REV. SHEET	
2-1		A 179613 1 OF 1	